

**性能特点：**

- 工作方式：将输入脉冲信号转换为互补信号输出
- 工作电压：-5V
- 输入电平：兼容 TTL 电平
- 输出电平：0/-5V
- 静态电流：4mA
- 芯片尺寸：2.1mm×1.13mm×0.1mm

**产品简介：**

HH-FEN6A 是 6 位 FET 驱动器芯片，采用 GaAs 工艺制作，可将输入的 TTL 脉冲信号生成 0V/-5V 的互补脉冲信号输出。芯片尺寸为 2.1mm×1.13mm×0.1mm。

**电参数：** (  $T_A=+25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{EE}=-5\text{V}$  )

参数名称	符	最小值	典型值	最大值	单位	说明
电源电压	$V_{EE}$	-5.5	-5	-4.5	V	芯片正常工作电压
静态电流	$I_{EE}$	-	4	-	mA	芯片上电后的电流
输入高电平	$V_{IH}$	2.8	5	5	V	A1-A6脚的输入电压，兼容 TTL 电平
输入低电平	$V_{IL}$	0	0	0.4	V	
输入电流	$I_i$	-	0.4	-	mA	-
输出高电平	$V_{OH}$	-	0	-	V	同相端和反相端 ( 1A、1B)
输出低电平	$V_{OL}$	-	-5	-	V	
每路输出 ( 驱动 ) 电流	$I_o$	-	2	-	mA	与负载有关
工作频率	f	0	10	30	MHz	与负载有关
开关时间	t	-	16	25	ns	-
温度	$T_A$	-55	25	85	$^{\circ}\text{C}$	-

**使用限制参数：** (超过以下任何一项最大限额都有可能造成永久损坏)

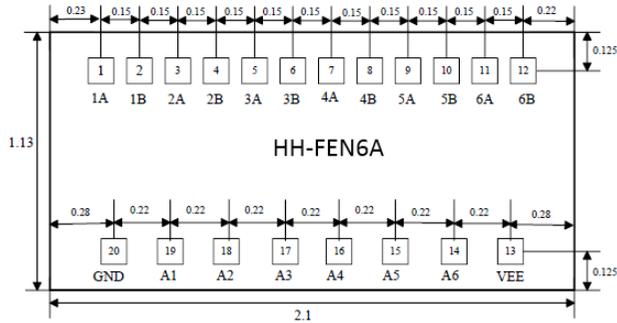
电源电压	-6V
输入高电平	5.5V
输入低电平	-0.5V
存储温度	-65 $^{\circ}\text{C}$ ~+150 $^{\circ}\text{C}$

真值表：

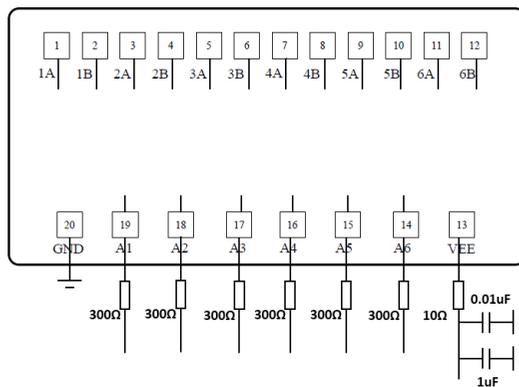
输入						输出											
A1	A2	A3	A4	A5	A6	1A	1B	2A	2B	3A	3B	4A	4B	5A	5B	6A	6B
Li	Li	Li	Li	Li	Li	Lo	Ho										
<b>Hi</b>	Li	Li	Li	Li	Li	<b>Ho</b>	<b>Lo</b>	Lo	Ho								
Li	<b>Hi</b>	Li	Li	Li	Li	Lo	Ho	<b>Ho</b>	<b>Lo</b>	Lo	Ho	Lo	Ho	Lo	Ho	Lo	Ho
Li	Li	<b>Hi</b>	Li	Li	Li	Lo	Ho	Lo	Ho	<b>Ho</b>	<b>Lo</b>	Lo	Ho	Lo	Ho	Lo	Ho
Li	Li	Li	<b>Hi</b>	Li	Li	Lo	Ho	Lo	Ho	Lo	Ho	<b>Ho</b>	<b>Lo</b>	Lo	Ho	Lo	Ho
Li	Li	Li	Li	<b>Hi</b>	Li	Lo	Ho	Lo	Ho	Lo	Ho	Lo	Ho	<b>Ho</b>	<b>Lo</b>	Lo	Ho
Li	Li	Li	Li	Li	<b>Hi</b>	Lo	Ho	<b>Ho</b>	<b>Lo</b>								
Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Hi	Ho	Lo										

注：以 0/5V 的输入脉冲电平 and -5V 的电源电压为例，Li 表示 0V，Hi 表示 5V，Lo 表示 -5V，Ho 表示 0V。

尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



## 使用说明：

**工作条件：**输入端应串联  $300\Omega \sim 3K\Omega$  的保护电阻，在满足开关速度的前提下，保护电阻越大越好。

**存储：**芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

**清洁处理：**裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

**静电防护：**请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

**常规操作：**拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

**装架操作：**芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

**键合操作：**输入输出各用 2 根（建议直径  $25\mu\text{m}$  金丝）键合线，键合线长度小于  $250\mu\text{m}$  最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。